

异形晶圆切割高校科研单面抛光硅片精密打孔划片切片加工

产品名称	异形晶圆切割高校科研单面抛光硅片精密打孔划片切片加工
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

异形晶圆切割高校科研单面抛光硅片精密打孔划片切片加工，采用进口光纤激光器和进口高精度振镜，光束质量好，性能稳定可靠，加工速度快，效率高。华诺激光，立足北京，为您服务，联系刘经理欢迎来电，我们将竭诚为您服务！

晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。

华诺激光专注于微米级的激光精密切割、钻孔、刻线、划片、材料去除、构造、雕刻和特殊材料的打标，主要应用于LED芯片制造，触摸屏，LCD，消费类电子，半导体，MEMS，照明，医疗等行业，以及科研、航天航空、军事等领域，涉及包括各种金属及合金、半导体、陶瓷、各种透明材质、薄膜和聚合物等各种材料，公司已经做过1000多个基于以上材料的各种激光微加工试验和方案。